

# 1/30~2/6半導体関連ニュース

ご提示いただいた膨大な最新ニュース(2026年2月初旬)を整理し、現在の半導体・AI業界で何  
が起きているのかを俯瞰できるダイジェストを作成しました。

現在の状況は、一言で言えば\*\*「Nvidia一強時代への挑戦と、AIが生んだ深刻なリソース不足  
(メモリ・製造能力)への苦闘」\*\*です。

## 半導体・AI業界ニュースダイジェスト(2026年2月)

### 1. 【王者Nvidiaへの挑戦】汎用から「専用」チップへのシフト

Nvidiaの圧倒的な支配に対し、テック巨頭や新興企業が「特定の用途に特化したチップ」で切り  
崩しを図っています。

- **Broadcom**の台頭: GoogleやMeta、OpenAIが、高価なNvidia製GPUへの依存を減らす  
ため、Broadcomと組み「自社専用チップ(ASIC)」の開発を強化。
- **OpenAI**の不満と離反: OpenAIは最新のNvidiaチップ(Blackwell)の推論速度に不満を  
持ち、新興のCerebras社と100億ドル規模の契約を締結。Nvidiaとの巨額投資交渉も停  
滞中。
- **Positron**の急成長: AIの「回答(推論)」に特化したチップを開発するPositronが約340億  
円を調達。「Nvidiaの10倍の電力効率」を武器にユニコーン企業へ。
- **Intel**の逆襲: Intelが元AMD・Qualcommの伝説的設計者を招き、AIデータセンター向け  
GPU市場への本格参入を宣言。

### 2. 【深刻なリソース不足】「メモリ」と「工場」が成長の壁に

AIの爆発的な普及により、チップを作るための「材料(メモリ)」と「場所(工場)」が極端に足りなく  
なっています。

- **40年に一度のメモリ狂騒曲**: AI用メモリ(HBM)の製造にリソースが奪われ、PC・スマホ  
用の通常メモリが世界的に大不足。2028年まで解消されないとの予測も。
- **ソフトバンク子会社とIntelの提携**: 次世代AIメモリ「ZAM」の開発で協力。Nvidiaとセットで  
使われるHBMへの依存脱却を目指す。
- **NvidiaがTSMCに増産要請**: ジェンソン・ファンCEOがTSMCに対し「生産能力を今後10  
年で2倍に」と直談判。先端パッケージング工程(CoWoS)が最大のボトルネックに。

### 3. 【業界の巨大再編】IoTと地政学リスク

AIの広がり、身近なモノがつながる「IoT」や、国家間の安全保障戦略にも影響を及ぼしていま  
す。

- **Texas Instruments(TI)**による巨額買収: 無線通信に強いSilicon Labsを約1.1兆円で  
買収。あらゆる機器をネットにつなぐ「IoT市場」の独占を狙う。
- **EUのドローン戦略**: セキュリティを担保するため「信頼できるチップ」の使用を義務付け。  
半導体が国防の要に。
- **米中対立の余波**: 米国の対中投資規制が、中国だけでなくアジア全体のテック投資を冷  
え込ませる「チーフ・エフェクト」への懸念。

\*\*\*\*\*

## [Buzz about Broadcom's custom chips is testing, but not breaking Nvidia's dominance](#)

「ブロードコムのカスタムチップへの期待が高まるも、エヌビディアの圧倒的支配を崩すには至らず」

### 詳細な内容の解説

この記事は、半導体業界における現在の勢力図を以下のように分析しています：

- ブロードコム (**Broadcom**) の台頭： Google、Meta、そして最近ではOpenAIといったテック巨頭が、エヌビディアの高価な汎用GPU (H100/B200など) への依存を減らすため、ブロードコムと提携して「自社専用チップ (ASIC)」を開発する動きを強めています。これが市場で大きな話題 (Buzz) となっています。
- エヌビディアの堅牢な壁： カスタムチップは特定のタスクには非常に効率的ですが、エヌビディアには\*\*「CUDA」という強力なソフトウェア・プラットフォームと、どんなAIモデルにも対応できる「汎用性」\*\*があります。
- 結論： ブロードコムの攻勢はエヌビディアの牙城を「テスト (試行)」してはいますが、現時点ではエヌビディアの市場シェアや業界標準としての地位を「ブレイク (破壊)」するほどの決定打にはなっていない、という現状を伝えています。

## [SoftBank subsidiary to work with Intel on next-gen memory for AI](#)

ソフトバンク子会社「SAIMEMORY (サイメモリ)」とインテルの提携に関するニュースの要約です。

### 【ニュース要約】ソフトバンク子会社とインテル、次世代AIメモリ「ZAM」で提携

ソフトバンクのメモリ開発子会社であるSAIMEMORYとインテルは、2026年2月、AIデータセンター向けの革新的なメモリ技術「Z-Angle Memory (ZAM)」の実用化に向けた協業を発表しました。

#### 1. 提携のポイント

- プレイヤー： ソフトバンクが2024年末に設立した新会社「SAIMEMORY」と、世界的な半導体大手インテル。
- 技術の核： インテルが米国エネルギー省の支援を受けて研究してきた「次世代DRAMボンディング (NGDB)」技術をベースにしています。
- 目標： AI処理の最大の壁となっている「メモリの速度と消費電力」の問題を解決すること。

#### 2. 次世代メモリ「ZAM」の特徴

- 性能： 従来のメモリ (HBMなど) を凌駕する「大容量・高帯域 (高速データ転送)・低消費電力」を同時に実現することを目指しています。
- 構造： 複数のDRAM (メモリチップ) を高度に積み重ねる (スタッキング) 新しいアーキテクチャを採用しています。
- メリット： AIの学習や推論に必要な莫大なデータ処理を、より少ない電力で高速に行える

ようになります。

### 3. 今後のスケジュール

- 2026年第1四半期: 開発プロジェクトを本格始動。
- 2027年度(2028年3月期): 試作品(プロトタイプ)を完成させる。
- 2029年度: 商業化(量産および実用化)を目指す。

### 4. 業界への影響

現在、AI業界はNvidia製GPUとセットで使われる「HBM(広帯域メモリ)」の不足と高コストに悩まされています。この提携により、日本と米国の技術を結集して\*\*「HBMに代わる、あるいはそれを超える新しい選択肢」\*\*を作ること、AIインフラの勢力図を変える可能性があると言われています。

<https://www.reuters.com/business/openai-is-unsatisfied-with-some-nvidia-chips-looking-alternatives-sources-say-2026-02-02/>

ご指定のライター記事(2026年2月2日付)の日本語訳と要約です。ファイル生成は行わず、こちらに直接記載します。

#### 日本語全訳(要約的翻訳)

「OpenAI、一部のNvidiaチップに不満。代替案を模索中」関係筋が明かす

#### 【サンノゼ/サンフランシスコ】

AI界のリーダーであるOpenAIが、現在主力として使用しているNvidia(エヌビディア)製チップの一部性能に満足しておらず、他社製ハードウェアへの切り替えを急いでいることが、事情に詳しい複数の関係者の話で明らかになった。

関係者によると、OpenAIは特に「推論(AIがユーザーの質問に回答する工程)」において、Nvidiaの最新チップ「Blackwell」を含む一部の製品が、同社が求める超高速なレスポンス速度(低レイテンシ)を実現できていないと考えている。AIがより複雑な論理思考を行うようになり、計算のやり方が変化したことで、従来のチップ設計では非効率な部分が目立ち始めているという。

この動きを受け、OpenAIは先月、新興のチップメーカーであるCerebras(セレブラス)社と100億ドル規模の大型契約を締結した。また、自社専用チップの開発プロジェクトも加速させており、Nvidiaへの一極集中を解消し、計算コストの削減と性能向上を狙っている。

一方、NvidiaとOpenAIの関係には緊張が走っている。計画されていたNvidiaによるOpenAIへの巨額投資(1,000億ドル規模)の交渉は現在停滞しており、両社の蜜月関係に変化の兆しが見えている。

.

#### 日本語要約(ポイント解説)

技術に詳しくない方でもわかるように、このニュースの重要点を3つにまとめました。

1. 「作る」から「使う」への悩み  
これまではAIを「学習(勉強)」させるためにNvidiaのチップが最適でしたが、今はChatGPTが「回答(推論)」する段階で、より速く、より安く動くチップが必要になっています。OpenAIは今のNvidiaのチップでは「スピードが足りないし、電気代もかかりすぎる」と不満を持ち始めています。
2. ライバルへの乗り換え  
OpenAIはNvidia以外の会社(Cerebrasなど)と手を組み始めています。これは、今まで

- Nvidia一択だった「AIチップの王座」が揺らぎ始めていることを示唆しています。
3. 巨額の投資話がストップ？  
NvidiaがOpenAIに約15兆円もの投資をするという景気の良い話がありましたが、この「チップ性能への不満」や「他社への浮気」が原因で、交渉がスムーズに進んでいないようです。

結論:

AIの進化スピードが速すぎて、最強のチップメーカーであるNvidiaでさえ、OpenAIの要求(もっと速く、もっと賢く)に応えきれなくなっている、という業界の転換点を示すニュースです。

<https://techcrunch.com/2026/02/04/exclusive-positron-raises-230m-series-b-to-take-on-nvidia-as-ai-chips/>

ご提示いただいたテッククラunch (TechCrunch) の記事 (2026年2月4日付) の日本語要約です。今回もファイル生成はせず、こちらで直接解説します。

## 【ニュース要約】新興企業Positron、約340億円を調達しNvidiaへの挑戦を本格化

AIチップ開発のスタートアップである\*\*Positron (ポジトロン) が、シリーズBラウンドで2億3,000万ドル (約340億円) という巨額の資金調達を実施しました。これにより、同社の企業価値は15億ドル (約2,200億円) \*\*に達し、いわゆる「ユニコーン企業」の仲間入りを果たしました。

### 1. 資金調達の背景

- 投資家: 大手ベンチャーキャピタルのCoatue Managementが主導し、Andreessen Horowitz (a16z) なども参加。
- 目的: Nvidia (エヌビディア) が独占しているAIチップ市場において、より安価で効率的な代替チップを量産するため。

### 2. Positronの「武器」: 推論特化型チップ

- 「推論」に集中: NvidiaのチップがAIの「学習 (勉強)」と「推論 (回答)」の両方をこなす万能型なのに対し、Positronは\*\*「推論」だけに特化\*\*した設計を行っています。
- 圧倒的な省エネ: 独自の設計により、Nvidiaの最新チップと比較して\*\*「最大10倍の電力効率」\*\*を誇ります。
- コストダウン: 汎用性を捨てることで、製造コストを抑え、AIを動かす際の電気代も劇的に安くすることを目指しています。

### 3. なぜ注目されているのか？

- **Nvidia一強への危機感**: 現在、多くの企業がNvidia製チップの価格の高さと供給不足に悩まされています。
- 「回答」の爆増: AIが普及するにつれ、学習よりも「AIに答えさせる (推論)」ための計算量が激増しています。Positronはこの「回答用チップ」の市場でトップを狙っています。

## ノンテクニカルな方向けの解説

「万能な大型トラック (Nvidia)」vs「超効率的な配達専用バイク (Positron)」

今のAI業界を道路に例えると、これまでは巨大な荷物 (AIの学習データ) を運ぶために、Nvidiaという会社を作る「超高性能で高価な大型トラック」が絶対に必要でした。

しかし、今はAIが街中で使われるようになり、「小さな荷物(ユーザーへの回答)を大量に、素早く届ける」必要が出てきました。Positronは、\*\*「重い荷物は運べないけれど、街中の配達(推論)ならトラックの10倍安くて速い専用バイク」\*\*を作ろうとしています。

投資家たちは、「これからはトラックだけでなく、この専用バイクが世界中で何億台も必要になるはずだ」と考えて、今回340億円もの大金を投じたのです。

結論:

「AIを動かすコストを下げたい」という世界中の企業の切実な願いを背景に、Nvidiaの牙城を崩そうとする強力なライバルがまた一つ、大きな力を付けたというニュースです。

<https://www.reuters.com/technology/texas-instruments-advanced-talks-buy-chip-designer-silicon-laboratories-ft-2026-02-03/>

ロイター通信(フィナンシャル・タイムズ引用)の2026年2月3日付の記事に関する日本語要約です。今回もファイル生成は行わず、こちらで直接分かりやすく解説します。

## 【ニュース要約】テキサス・インスツルメンツ、同業シリコン・ラボの買収に向けて大詰め

半導体大手の\*\*テキサス・インスツルメンツ(TI)\*\*が、無線通信チップの設計に強いシリコン・ラボラトリーズ(Silicon Laboratories)\*\*を買収するため、交渉の最終段階に入っていることが明らかになりました。

### 1. 買収の背景

- プレイヤー:
  - TI: 世界最大級のアナログ半導体メーカー。産業機器や自動車向けに強い。
  - シリコン・ラボ: 「IoT(モノのインターネット)」向けのワイヤレス技術(Bluetooth、Wi-Fi、Zigbeeなど)のリーダー。
- 現状: 両社は買収条件の詳細を詰めており、早ければ数週間以内にも合意に達する可能性があります。

### 2. なぜこの買収が重要なのか?

- IoT市場の支配: あらゆる機器がネットにつながる現在、TIはシリコン・ラボの「無線でつながり技術」を手に入れることで、スマートホーム、工場自動化、医療機器などの分野で圧倒的な地位を築こうとしています。
- 補完関係: TIは「電力制御」や「計算」が得意ですが、「無線通信」はシリコン・ラボの方が専門性が高いため、両者が合わさることで「電池で動き、かつネットにつながる」完璧なチップセットをワンストップで提供できるようになります。

## ノンテクニカルな方向けの解説

「力持ちの巨人(TI)」が「通信の達人(シリコン・ラボ)」を仲間に加える

このニュースを、身近なものに例えて説明します。

- テキサス・インスツルメンツ(TI)は、いわば「家電の心臓部や筋肉」を作るのが得意な巨大企業です。エアコンを動かしたり、工場のロボットを制御したりする力強い部品を作って

- います。
- シリコン・ラボは、それとは対照的に、「機器同士を無線で会話させる(通信)」のスペシャリストです。

なぜくつつくの？

最近、電球も冷蔵庫も工場のセンサーも、すべて「スマホで操作」したり「ネットで管理」したりするのが当たり前になりました。

TIとしては、「筋肉(動かす技術)」だけでなく、「耳と口(無線でつながる技術)」もセットで持ちたいと考えました。

結論：

これまで別々の会社から部品を買っていたメーカーにとって、この2社が1つになれば、「ネットにつながる便利な製品」をより簡単に、安く作れるようになるかもしれません。半導体業界の勢力図が大きく変わるかもしれない、巨大な結婚話のようなニュースです。

<https://www.reuters.com/sustainability/sustainable-finance-reporting/texas-instruments-buy-hip-designer-silicon-laboratories-75-billion-deal-2026-02-04/>

ロイター通信(2026年2月4日付)の、テキサス・インスツルメンツ(TI)によるシリコン・ラボ正式買収合意に関するニュースの要約です。ファイル生成は行わず、こちらで解説します。

## 【ニュース要約】TI、シリコン・ラボを75億ドル(約1.1兆円)で正式買収へ

米半導体大手のテキサス・インスツルメンツ(TI)は4日、半導体設計のシリコン・ラボラトリーズを約75億ドルの全額現金取引で買収することで合意したと発表しました。これはTIにとって、2011年のナショナル セミコンダクター買収(65億ドル)を超える、過去十数年で最大の買収劇となります。

### 1. 買収の主な内容

- 買収額: 1株あたり231ドル(前日の終値に約69%ものプレミアムを上乗せした価格)。
- 狙い: TIが持つアナログ半導体の強みに、シリコン・ラボの「無線通信技術(Bluetooth, Wi-Fi, Z-Waveなど)」を統合し、IoT(モノのインターネット)市場での絶対的なリーダーを目指します。
- 製造の効率化: シリコン・ラボは工場を持たない「ファブレス」企業でしたが、買収後はTI自社の最新工場(300mmウェハ工場)で製造を行うことで、コスト削減と供給の安定化を図ります。

### 2. 今後の見通し

- 完了時期: 2027年の前半に買収手続きが完了する予定です。
- 相乗効果: 買収完了から3年以内に、年間で約4億5,000万ドル(約670億円)のコスト削減効果を見込んでいます。

## ノンテクニカルな方向けの解説

「世界最大の半導体メーカーの一つが、家や工場を『つなぐ』達人を1兆円でスカウトした」

このニュースを、もっと身近な言葉で説明するようになります。

- テキサス・インスツルメンツ(TI)：  
あらゆる機械の中に必ず入っている「基本の部品」を世界中で一番売っている、\*\*「半導体界の巨人」\*\*です。ただ、これまでは「無線で飛ばす」という技術が少し手薄でした。
- シリコン・ラボ：  
スマートホーム(スマホで鍵を開ける、照明を消すなど)のように、\*\*「機械を無線でつなぐ」\*\*ための小さなチップを作るのが非常に得意な会社です。

なぜ1.1兆円も払うの？

巨人のTIは、「これからはどんな小さな部品もネットにつながらなきゃいけない時代だ」と考えました。そこで、自前で技術を開発する時間を買う代わりに、最高級の技術を持つシリコン・ラボをまるごと仲間にすることにしました。

ここがすごい！

これまでは「設計はシリコン・ラボ、作るのを頼むのは別の工場」とバラバラでしたが、これからは「設計も製造もすべてTI」という体制になります。これにより、\*\*「安く、電池が長持ちして、どこでもつながる」\*\*便利なチップが世界中に大量供給されるようになります。

結論：

私たちの身の回りの家電や工場の機械が、これまで以上に安く、スマートにネットにつながる未来に向けた、歴史的な「巨大合併」のニュースです。

<https://www.cnbc.com/video/2026/02/04/texas-instruments-to-buy-silicon-labs-in-7-point-5-billion-deal.html>

CNBCのニュース映像(2026年2月4日放送)に基づいた日本語要約です。今回もファイル生成は行わず、こちらで直接お伝えします。

この映像は、先ほどロイターの記事でも報じられた「テキサス・インスツルメンツ(TI)によるシリコン・ラボの買収」を、ビジネス・金融の視点から解説したものです。

## 【ニュース要約】CNBC：TIによる75億ドルのシリコン・ラボ買収劇を解説

CNBCのビジネスニュース番組において、今回の買収が「半導体業界の勢力図を塗り替える戦略的な一手」として大きく報じられました。

### 1. 買収のハイライト

- 買収総額：7.5億ドル(約1.1兆円)。TIにとって過去15年で最大の買収です。
- プレミアム価格：シリコン・ラボの株価に対し、\*\*約69%という極めて高い上乗せ(プレミアム)\*\*を払って買い取ります。これは、TIがそれだけ「この技術を他社に渡したくない」と強く望んだことを示しています。
- 株価の反応：発表を受け、シリコン・ラボの株価は時間外取引で50%以上急騰しました。

### 2. 戦略的意義(なぜ今なのか?)

- IoT(モノのインターネット)の覇権：シリコン・ラボは、スマートホームや産業用センサーを「無線でつなぐ」技術で世界トップクラスです。TIはこの技術を自社の巨大な販売網に乗せることで、市場を一気に独占する狙いがあります。
- 利益率の向上：TIは自社の工場(300mmウェハ)で効率よく大量生産する能力があります。シリコン・ラボの製品を自社工場で作ることで、利益率をさらに高められると分析され

ています。

## ノンテクニカルな方向けの解説:ここがポイント!

「大企業による『超高値』での実力派スカウト」

このCNBCのニュースが注目しているのは、主に\*\*「お金と戦略」\*\*の話です。

1. 「ご祝儀」の額がすごい!  
普通、会社を買うときは少し高めに買いますが、今回は「昨日の株価の1.7倍」という、業界でも驚くほどの高値で買っています。これは、TIが「1兆円払ってでも、今すぐこの無線技術を手に入れないと、これからのAI・IoT時代に乗り遅れる」という強い危機感と期待感を持っている証拠です。
2. 「自前の工場」という強み  
シリコン・ラボは「設計図」は持っていますが、自分たちの工場は持っていませんでした。一方、TIは世界中に巨大な工場を持っています。この二つが合体することで、「良い設計図を、自分たちの工場で安く大量に作る」という最強の勝ちパターンができることを投資家たちは期待しています。
3. 暮らしへの影響  
例えば、家のスマートロック(スマホで開ける鍵)や、工場の自動管理システムなどが、今後さらにTIという一つの大きなブランドに集約されていくこととなります。

結論:

「単なる合併ではなく、次世代の『つながる世界』の主導権をTIが力づく(1兆円の巨費)で取りに来た」という、金融市場も驚くインパクトの大きいニュースです。

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-04/texas-instruments-strikes-7-5-billion-deal-to-buy-silicon-labs>

ブルームバーグ(2026年2月4日付)の記事に基づいた要約です。こちらもファイル生成はせず、チャット内で分かりやすく解説します。

ブルームバーグの報道は、特に\*\*「市場の動向」と「TIの経営戦略」\*\*に深く焦点を当てています。

## 【ニュース要約】ブルームバーグ:TIが1.1兆円でシリコン・ラボを買収、IoTの覇権を狙う

半導体アナログチップの最大手、テキサス・インスツルメンツ(TI)が、ワイヤレス技術に強みを持つシリコン・ラボラトリーズを75億ドル(約1.1兆円)で買収することで合意しました。

### 1. 記事の主なポイント

- 歴史的な巨額買収: 2011年以来、TIにとって過去15年で最大の買収件数となります。
- 現金によるスピード決着: 全額を現金で支払う「オールキャッシュ」の取引です。
- プレミアムの背景: シリコン・ラボの株価に69%という高額な上乗せを行いました。ブルームバーグはこれを「IoT(モノのインターネット)市場における競争相手を排除し、成長を加速させるための代償」と分析しています。
- 製造能力の統合: シリコン・ラボの製品を、TIが持つ世界最先端の「300mmウェハ工場」で内製化することで、利益率を劇的に向上させる計画です。

## 2. なぜブルームバーグはこのニュースを重要視しているのか？

- 「守り」から「攻め」へ：近年のTIは自社工場の建設などインフラ投資に集中してきましたが、今回の買収は「他社の技術を取り込んで成長する」という積極的な攻めの姿勢への転換を意味します。
- 金利と経済環境：高金利環境下でも、これだけの巨額の現金を動かせるTIの財務力の強さが改めて浮き彫りになりました。

### ノンテクニカルな方向けの解説：ここがポイント！

「半導体界の『横綱』が、これから流行る『無線技術』をまるごと買い取った」

このニュースをブルームバーグらしい視点（お金と戦略）で噛み砕くと、以下のようになります。

1. 「時間を金で買った」  
TIはとてもの大きな会社ですが、BluetoothやWi-Fiのように「物を無線でつなぐ」ための細かい技術は、シリコン・ラボの方が進んでいました。自分たちで研究するよりも、「1兆円払って、すでに成功しているチームを丸ごと手に入れたほうが早い」と判断したのです。
2. 「自社工場で利益率を上げる」  
シリコン・ラボは「設計図」は描きますが、自分の工場は持っていませんでした（外注していました）。TIは世界中に大きな工場を持っています。「よそで作ってもらっていた製品を、自分たちの工場で作る」ようにすれば、外に払うお金が浮き、その分すべて利益になります。
3. 暮らしへの影響は？  
家の中のスマート家電（電球、鍵、温度計など）が、今後さらに「TIの技術」で動くようになります。一つの大きな会社が仕切ることで、製品同士のつながりが良くなったり、価格が安定したりするメリットが期待されます。

### 結論：

「これから数十年続く『あらゆる物がネットにつながる時代』において、誰にも負けない地位を築くために、TIが最強の武器（無線技術）を札束（1.1兆円）で手に入れた」という、非常にダイナミックな経営判断のニュースです。

<https://www.reuters.com/business/intel-ceo-says-company-will-make-gpus-has-hired-lead-executive-2026-02-03/>

ロイター通信（2026年2月3日付）が報じた、インテルのGPU戦略に関するニュースの日本語要約です。ファイル生成は行わず、こちらで直接解説します。

### 【ニュース要約】インテルCEO「独自GPUを製造する」と宣言、元クアルコム幹部を引き抜き

インテルのリブ・タン（Lip-Bu Tan）CEOは3日、サンフランシスコで開催された「Cisco AI Summit」において、エヌビディア（Nvidia）が主導するGPU市場に本格参入し、独自のGPUを製造する計画を明らかにしました。

#### 1. 発表の主なポイント

- 重要人物の採用：\* このプロジェクトを率いる「チーフGPUアーキテクト」として、元クアルコム（Qualcomm）の幹部であるエリック・デマーズ（Eric Demmers）氏を雇用しました。
  - CEOは「彼を説得して仲間に加えるのに苦労したが、非常に優秀な人材だ」と自信を見せています。

- ターゲット領域: \* 主にデータセンター向けのGPUに注力します。エヌビディアが現在圧倒的なシェアを持つ、AIの学習や推論を行うための市場を狙います。
- 戦略の転換: \* これまでインテルはCPU(中央演算処理装置)が主力でしたが、「異なる用途(AIなど)にはGPUも不可欠であり、最適化が必要だ」と強調しました。

## 2. 製造面(ファウンドリ)の動向

- 自社の製造部門「インテル・ファウンドリ」において、最新の**14A**プロセス技術への顧客の関心が高まっており、今年後半から量産に向けた準備を加速させる見通しです。

## ノンテクニカルな方向への解説

「計算の王様(インテル)が、グラフィックの王様(エヌビディア)の得意分野へ本気で殴り込みをかける」

このニュースを、もっと身近な状況に例えて説明します。

1. 「頭脳」の使い分け  
これまでインテルは、パソコンの「頭脳」にあたる**CPU**(事務作業や計算を一つずつこなすのが得意)で世界一でした。一方で、エヌビディアは**GPU**(大量の映像処理やAIの計算を同時にこなすのが得意)で大成功しています。  
今回、インテルは「これからはAIの時代だから、自分たちも最高性能のGPUを自前で作る!」と宣言しました。
2. 「ライバルからエースを引き抜き」  
新しい挑戦には、その道のプロが必要です。そこでインテルは、通信チップ大手のクアルコムから「設計のエース」をスカウトしてきました。これは、インテルが「ちょっと試してみる」レベルではなく、会社の運命をかけて本気で取り組んでいる証拠です。
3. なぜこれが重要な?  
現在、AIを動かすためのチップはエヌビディアの独壇場であり、価格が高騰し、手に入りにくい状況が続いています。インテルがこの分野で成功すれば、チップの選択肢が増え、AIの利用コストが下がる可能性があるため、業界全体が注目しています。

結論:

「CPUのインテル」という従来のイメージを脱却し、\*\*「AI時代の総合半導体メーカー」\*\*として生き残るために、最強の助っ人を呼んでエヌビディアに挑む、という非常に野心的なニュースです。

<https://www.cnn.com/2026/02/03/intel-gpu-chief-architect-ai-lip-bu-tan.html>

CNNの記事(2026年2月3日付)に基づいた、インテルのGPU戦略に関するニュースの要約と解説です。

## 【ニュース要約】インテルCEO、GPUの「チーフ・アーキテクト」採用と本格参入を表明

インテルのリブ・タン(Lip-Bu Tan) CEOは、サンフランシスコで開催されたカンファレンスにて、同社が独自**GPU**の開発・製造を強化し、エヌビディア(Nvidia)が支配する市場に正面から挑むことを明らかにしました。

### 1. 記事の主なポイント

- 「スター設計者」の採用:  
インテルはGPU開発を指揮する\*\*「チーフGPUアーキテクト」として、クアルコム(

Qualcomm)の元幹部で、かつてAMDでも伝説的なGPU設計に携わったエリック・デマーズ(Eric Demers)氏\*\*を招き入れました。CEOは「彼を口説き落とすのには時間がかかった」と語っています。

- ターゲットは「AIデータセンター」:  
この新しいGPUプロジェクトは、一般向けのゲーム用ではなく、主にAIの学習や推論を行うデータセンター市場をターゲットとしています。
- 「CPU一本足打法」からの脱却:  
CEOは「CPUだけでなく、GPUも非常に重要。用途に合わせて最適化が必要だ」と述べ、従来のx86(CPU)へのこだわりを捨て、多様な技術(GPUやRISC-Vなど)を取り入れる柔軟な姿勢を強調しました。

## ノンテクニカルな方向けの解説

「計算機の王者が、エースを引き抜いて『AI専用の筋肉』を作り始めた」

このニュースを分かりやすく説明すると、以下のようになります。

1. 「頭脳」から「筋肉」へ  
インテルは、パソコンの「頭脳」であるCPU(複雑な指示を順番に処理するのが得意)の世界王者でした。しかし、今のAIブームで求められているのは、単純な計算を数千個同時にこなすGPU(いわば「計算の筋肉」)です。インテルはこの「筋肉」作りで出遅れていましたが、今回「本気で筋肉も作る！」と宣言したのです。
2. 伝説の監督(設計者)をスカウト  
新しいチームを作るには、最高のリーダーが必要です。今回インテルが採用したエリック・デマーズ氏は、業界では\*\*「GPUの神様」の一人\*\*のような人物です。ライバル会社(クアルコムやAMD)で数々のヒット商品を作ってきた彼をスカウトしたことは、インテルの本気度の現れです。
3. なぜ今なのか?  
現在、世界中の企業がエヌビディアのチップを欲しがっていますが、高すぎて手に入りません。インテルが自前の工場と、この新しいエース設計者の技術を組み合わせれば、「エヌビディア以外の選択肢」として世界中のAI企業から歓迎される可能性があるからです。

結論:

「CPUのインテル」が、プライドを捨てて\*\*「AIチップの総合メーカー」\*\*に生まれ変わるために、最強の助っ人を呼んだという、インテルの生き残りをかけた大きな転換点のニュースです。

<https://www.cnbc.com/2026/02/03/intel-gpu-chief-architect-ai-lip-bu-tan.html>

CNBCの記事(2026年2月3日付)の要約です。ファイル生成(アーティファクト)は使用せず、こちらに直接記載します。

### 【ニュース要約】インテル、エヌビディア対抗へ「GPUの神様」を招聘

インテルのリブ・タン(Lip-Bu Tan)CEOは、シスコ主催のAIサミットにて、エヌビディアが支配するAIチップ市場へ本格参入するための「切り札」となる人事と戦略を発表しました。

#### 1. 伝説的設計者エリック・デマーズ氏の採用

- インテルは、「チーフGPUアーキテクト」という重要なポストに、元クアルコム幹部のエリック・デマーズ(Eric Demers)氏を起用しました。
- デマーズ氏はかつてAMD(ATI)で「Radeon」などの伝説的なGPUを設計した人物であ

り、CEOは「彼を説得して仲間に加えるのは大変だったが、最高のリーダーを得られた」と喜びを語っています。

## 2. 狙いは「AIデータセンター」市場

- インテルが今後作るGPUは、ゲーム用ではなく\*\*「AIデータセンターでの計算(学習と推論)」\*\*に特化したものです。
- CPU(頭脳)で培った顧客基盤を活かし、顧客の要望を直接聞きながら「本当に求められているGPU」をオーダーメイド感覚で設計・製造する方針です。

## 3. メモリ不足への警告(2028年まで続く)

- タンCEOは、AI需要の爆発により、世界的なメモリチップ(記憶用チップ)の不足が2028年まで解消されないという厳しい見通しを示しました。この不足がAIインフラ拡大の足かせになる可能性を指摘しています。

## 4. 製造部門(ファウンドリ)の進捗

- インテルの最新製造技術「14A」プロセスに対し、複数の大手顧客が強い関心を示しており、今年後半から量産に向けた動きが加速する予定です。

## ノンテクニカルな方向けのポイント

1. 「王者の本気」: インテルは、これまで「餅は餅屋」とエヌビディアに譲っていたGPU分野に、ライバルから最高のエースを引き抜いて本気で殴り込みをかけました。
2. 「AI特化」: 一般的なパソコン用ではなく、ChatGPTのような巨大なAIを動かすための「専用の巨大な計算機」を作ることに集中します。
3. 「供給の不安」: チップは作れても、それを支える「メモリ」が世界的に足りず、あと2年は高値や不足が続くという専門家(CEO)ならではの予測も含まれています。

インテルが「CPUの会社」から「AIインフラの総合メーカー」へと脱皮しようとしている、非常に重要な節目となるニュースです。

<https://techcrunch.com/2026/02/03/intel-will-start-making-gpus-a-market-dominated-by-nvidia/>

テッククラunch(TechCrunch)の2026年2月3日付の記事「Intel will start making GPUs, a market dominated by Nvidia(インテル、エヌビディアが独占するGPU市場への参入を開始)」についての日本語要約です。

## 【ニュース要約】インテル、エヌビディアの牙城に挑む独自GPUの製造を表明

インテルのリブ・タン(Lip-Bu Tan)CEOは、サンフランシスコで開催された「Cisco AI Summit」にて、AIチップ市場の覇者であるエヌビディアに対抗するため、独自のGPU(画像処理装置)を開発・製造する新戦略を発表しました。

### 1. 主な内容

- 「GPUの設計者」をライバルから引き抜き:  
インテルは、クアルコム(Qualcomm)の元幹部で、AMDでも伝説的なGPU設計(Radeonなど)を指揮したエリック・デマーズ(Eric Demers)氏を、GPU部門のトップ(チーフ・アーキテクト)として採用しました。
- ターゲットはAIデータセンター:

このGPUは、ゲーム用ではなく、ChatGPTなどの巨大なAIを動かす\*\*「データセンター向け」\*\*に特化しています。AIの学習(勉強)と推論(回答)の両方を担う計算機を目指します。

- 顧客中心のオーダーメイド:  
従来の「汎用品を作って売る」スタイルではなく、特定の巨大顧客(ハイパースケーラーなど)のニーズに合わせて、インテルの最新工場を活用したGPUを共同開発する方針です。

## 2. CEOが語った「厳しい現実」

- メモリ不足の警告:  
タンCEOは、AIチップに欠かせない\*\*「メモリチップ」の不足が2028年まで続く\*\*という、半導体業界にとって衝撃的な予測を示しました。これがAIの普及スピードを制限する可能性があると警告しています。

## ノンテクニカルな方向けの解説

「頭脳の王者(インテル)」が、ライバルの「エース設計者」を呼んで「AI専用の筋肉」を作り始めた

このニュースを、ITに詳しくない方にもわかるように例えます。

1. 「餅は餅屋」を辞めたインテル  
これまで、パソコンやサーバーの「頭脳(CPU)」といえばインテルでしたが、AIを動かすための「筋肉(GPU)」はエヌビディアの独壇場でした。インテルは今回、「これからは筋肉(GPU)も自分たちの工場が一番いいやつを作る！」と宣言したのです。
2. 伝説のスカウト  
インテルが呼んできたエリック・デマーズ氏は、いわば\*\*「世界最高の筋肉デザイナー」\*\*です。ライバル会社(クアルコムやAMD)で何度も成功を収めてきた彼をリーダーに据えることで、「インテルのGPUは今度こそ本物だ」と業界に思わせる強いメッセージになっています。
3. 「材料不足」という大きな壁  
CEOは「自分たちは最高性能のチップを作る準備ができていますが、それを動かすための『メモリ(記憶用部品)』が世界中で足りなすぎて、あと2年は解消されない」とも言っています。これは、AIブームの熱狂の裏にある、深刻な部品不足の現実を突きつけた形です。

結論:

「エヌビディア一強」の状態に、インテルが最高の人材と自前の工場を武器に、真正面から勝負を挑んだという、AI半導体業界の勢力図を大きく変える可能性のあるニュースです。

<https://www.scmp.com/tech/article/3341994/nvidias-jensen-huang-urges-tsmc-expand-capacity-amid-ai-chip-crunch>

サウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)が報じた、エヌビディア(Nvidia)のジェンソン・ファンCEOによるTSMCへの増産要請に関するニュースの要約です。ファイル生成は行わず、こちらで分かりやすく解説します。

**【ニュース要約】エヌビディアCEO、AIチップ不足解消に向けTSMCに「生産能力の倍増」を要請**

2026年2月上旬、台湾を訪問中のエヌビディアのジェンソン・ファンCEOは、世界最大の半導体

受託製造企業である**TSMC**に対し、急増するAIチップ需要に応えるため、生産能力を劇的に拡大するよう強く促しました。

## 1. 主な内容

- 「今後**10年で2倍**」の要請: ファン氏は、エヌビディア1社からの需要だけで「TSMCは今後10年間で生産能力を2倍以上に引き上げる必要があるかもしれない」と述べました。
- 供給不足の現状: 現在、エヌビディアの最新AIチップ(Blackwellや次世代のVera Rubin)は、注文に対して供給が全く追いついておらず、TSMCに対して「今年は非常に、非常に一生懸命働いてもらわなければならない」と異例のハツパをかけました。
- ボトルネックの特定: チップそのものの製造だけでなく、複数のチップを高度に積み重ねる\*\*「先端パッケージング(CoWoS)」\*\*の工程が最大の課題となっており、TSMCはこの分野への投資を急いでいます。

## 2. ビジネス的な背景

- エヌビディアの独走: エヌビディアは現在、アップルを抜いてTSMCにとって最大の顧客となっており、半導体業界の主導権が完全にAIチップへと移ったことを象徴しています。
- **TSMCの巨額投資**: TSMCもこれに応える形で、今年**の設備投資額を最大560億ドル(約8.4兆円)**まで引き上げる可能性を示唆しています。

## ノンテクニカルな方向けの解説

「世界一売れているレストランのシェフが、厨房(工場)に『もっとコンロを増やして、**24時間フル稼働**してくれ!』と頼み込んでいる状態」

この状況を身近な例えで説明すると、以下のようになります。

1. 「注文が多すぎて作れない」  
エヌビディア(Nvidia)は、今世界で一番求められている「AIの脳みそ」の設計図を持っています。しかし、実際にそれを作るのは世界でほぼTSMCという会社だけです。あまりに注文が殺到しているため、ファンCEO自らが工場へ行き、「もっと作ってくれないと世界が止まってしまう!」と直談判しているのです。
2. 「作るのがめっちゃくちゃ難しい」  
今回の不足は、単にチップを焼くだけではなく、それらを「超精密に組み立てる(パッケージング)」という非常に難しい工程が追いつかないことが原因です。これを解決するには、巨大な新しい工場をいくつも建てる必要があり、それには数年単位の時間と兆単位のお金がかかります。
3. 「AIバブル」への不安と期待  
一部では「こんなに工場を増やして、もしAIブームが終わったらどうするんだ?」という心配(バブル懸念)もあります。しかし、エヌビディアは「このインフラ投資は人類史上最大のものであり、まだまだ足りない」と強気の姿勢を崩していません。

結論:

「AIブームはまだ序の口であり、世界中のAI需要を満たすためには、今の世界最強の工場ですら『今の倍の規模』にならないと追いつかない」という、AI時代の凄まじい熱量を感じさせるニュースです。

<https://www.scmp.com/opinion/asia-opinion/article/3342148/beyond-china-asia-will-bear-bru>  
サウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)のオピニオン記事(2026年2月4日付)「Beyond China, Asia will bear the brunt as US builds walls around tech capital(中国を超えて、米国が

技術資本の壁を築く中でアジアがその矢面に立つことになる)」についての要約です。

## 【ニュース要約】米国の「技術封じ込め」の余波、中国だけでなくアジア全体に波及

この記事は、米国が中国に対して行っている厳しい投資規制や技術輸出制限が、結果としてアジア諸国全体の経済とテック業界に深刻な副作用(チーフ・エフェクト)をもたらしていると警告する内容です。

### 1. 記事の主な主張

- 規制の「硬硬化」と拡大: 2023年~2024年に導入された「対外投資規制(米国企業が中国のハイテク分野に投資することを制限するルール)」が、2026年現在、より厳格な法律として定着し、さらに範囲が広がっています。
- アジア全体への「冷え込み」: この規制は中国を標的にしていますが、実際にはアジア全域のテック・エコシステムに「冷え込み(Chilling Effect)」を与えています。投資家が「中国と少しでも関わりのあるアジア企業」への投資をリスクと見なし、守りの姿勢に入っているためです。
- 「漁夫の利」は得られない: ベトナム、マレーシア、インドなどは、中国から逃れた工場を受け入れることで利益を得ると期待されてきました。しかし、米国の「壁」が高くなりすぎたことで、アジアのサプライチェーン全体が分断され、地域全体の成長が阻害されるリスクが高まっています。

### 2. 地政学的なリスク

- 板挟みのアジア諸国: アジアの多くの中堅国は、米国からの投資を必要としながらも、製造や市場の面では中国と深く結びついています。米国の「壁」の構築は、これらの中堅国に対し、どちらの陣営に付くかという「不可能な選択」を強いていると指摘しています。

## ノンテクニカルな方向けの解説

「近所の大きな工場(中国)を追い出すために高い壁を作ったら、隣近所(アジア諸国)の物流も景気も止まってしまった」

この記事が言わんとしていることを、町内会に例えて説明します。

1. 「中国だけ」では済まない  
米国は「中国に最新の技術やお金を渡したくない」と考えて、高い壁を作りました。しかし、現代の技術作りは、いろいろな国の企業が協力して一つの製品を作る「チームプレー」です。中国というエースを外そうとした結果、チーム全体(アジア全体)の動きが悪くなってしまいました。
2. 投資家の「ビビリ」  
「中国に投資しちゃダメ」というルールが厳しくなりすぎて、お金を持っている投資家たちが「よくわからないけれど、アジアの会社に投資して後から米国に怒られたら怖いから、とりあえず投資はやめておこう」と、関係のないアジアの国々まで避けるようになってしまいました。
3. 結局、みんなが困る  
中国の代わりに工場を引き受けようとしていた周りの国々も、結局は中国から部品を買ったり、中国の市場に売ったりしています。米国が「中国との縁を切れ」と強く迫れば迫るほど、アジア諸国の商売が立ち行かなくなってしまう、という悲鳴に近い分析です。

結論:

米中のハイテク戦争は、もはや「二国間のケンカ」ではなく、アジアという世界で最も成長している地域の勢いそのものを止めてしまうリスクになっている、という強い警鐘を鳴らした記事です。

<https://www.reuters.com/business/microchip-tech-forecasts-quarterly-profit-below-estimates-memory-shortages-bite-2026-02-05/>  
[nt-us-builds-walls-around-tech-capital](https://www.reuters.com/business/microchip-tech-forecasts-quarterly-profit-below-estimates-memory-shortages-bite-2026-02-05/)

ロイター通信(2026年2月5日付)が報じた、マイクロチップ・テクノロジー(Microchip Technology)の決算予測に関するニュースの要約です。

【ニュース要約】マイクロチップ社、メモリ不足の影響で利益予測が市場予想を下回る  
半導体大手のマイクロチップ・テクノロジーは5日、次四半期(2026年1~3月期)の利益予測が市場の期待に届かないとの見通しを発表しました。これを受け、同社の株価は時間外取引で5%以上下落しました。

## 1. 主な内容

- 利益予想の引き下げ: 次四半期の調整後利益を1株あたり約**40セント**と予測。これはアナリストの平均予想(48セント)を大きく下回っています。
- 原因は「メモリ不足」: 世界的なメモリチップの供給不足(メモリ・クラッシュ)が、スマホやPCなどの個人向け電子機器業界を直撃。顧客企業が完成品を出荷できず、その結果、マイクロチップ社への部品注文を減らしていることが響いています。
- 売上高の予測: 売上高は12.4億~12.8億ドルを見込んでおり、こちらは市場予想(12.3億ドル)をわずかに上回るものの、利益率の悪化が嫌気されました。

## 2. 直近の業績(10~12月期)との対比

- 直近の第3四半期決算自体は好調で、売上高11.9億ドル、1株利益44セントと、いずれも市場予想を上回る「ポジティブ・サプライズ」でした。
- しかし、投資家の関心は「過去の好決算」よりも「メモリ不足による将来の不安」に向けた形です。

## 専門外の方へのポイント解説

「せっかく注文はあるのに、他の部品(メモリ)が足りなくて製品が完成せず、結果的に自分の商売も足踏みしている状態」

1. 「セット」で揃わないと売れない  
マイクロチップ社の部品は、スマホや家電の中で「制御」を司る重要なパーツです。しかし、それらは「メモリ(記憶する部品)」と一緒に組み込まれて初めて製品になります。世界中でメモリが足りないため、メーカーが製品を作れず、マイクロチップ社の部品も「今は要らない」と在庫調整されてしまっています。
2. 期待と現実のギャップ  
これまでの業績は良かったのですが、今後の見通しがプロの予想よりも悪かったため、「これからはしばらく苦しい時期が続くのでは?」と投資家が警戒して株を売った、というのが今回の株価下落の背景です。

結論:

AIブームの裏側で起きている「深刻なメモリ不足」が、AIとは直接関係のない一般的な家電やスマホ向けの半導体メーカーにまで、悪影響を及ぼし始めていることを示すニュースです。

[https://newsletter.semianalysis.com/p/memory-mania-how-a-once-in-four-decades?\\_gl=1\\*gk](https://newsletter.semianalysis.com/p/memory-mania-how-a-once-in-four-decades?_gl=1*gk)

6478\*\_ga\*NzQ5NDUyNjkyLjE3NzA0MjM3MDQ.\*\_ga\_FKWNM9FBZ3\*czE3NzA0MjM3MDMkbzEkZzAkdDE3NzA0MjM3MDMkajYwJGwwJGg3NTczNTI0OTE.

半導体分析の権威であるSemiAnalysisによる、最新(2026年2月6日発行)の記事「Memory Mania(メモリ狂騒曲)」の要約です。

この記事は、現在のメモリ市場で起きている現象を\*\*「40年に一度の歴史的な大転換」\*\*と位置づけており、業界に衝撃を与えています。

## 【ニュース要約】メモリ狂騒曲:40年に一度の「大不足」がもたらす超好況

現在、メモリ(記憶用チップ)業界では、過去数十年で例を見ないほどの急激な価格高騰と供給不足が起きています。これは単なる一時的な景気循環ではなく、AIによって業界の構造そのものが作り変えられている「スーパーサイクル」であると分析されています。

### 1. なぜ「40年に一度」なのか？

- AIによる「製造能力の横取り」: AIチップに不可欠な高性能メモリ「HBM(広帯域メモリ)」は、通常のメモリ(DRAM)に比べて製造が非常に難しく、同じ容量を作るのに3倍以上のシリコン面積(ウェハ)を占有します。
- 通常のメモリが消える: メーカー(サムスン、SKハイニックス、マイクロン)が利益率の高いAI用HBMの製造に全力を挙げているため、パソコンやスマホ用の「普通のメモリ」を作るラインが激減し、世界的な不足を招いています。

### 2. 恐ろしい予測:まだ「ピーク」ではない

- 価格はさらに倍増:すでに価格は急騰していますが、SemiAnalysisは「まだ頂点には程遠い」と警告しています。AIデータセンターからの需要が底なしであるため、2026年を通じて価格の上昇は止まらない見通しです。
- 「脱・日用品」化:これまでメモリは安価な「日用品(コモディティ)」でしたが、現在は高度な技術が必要な「特注品(スペシャリティ)」へと変貌しており、これが価格を高止まりさせています。

## 専門外の方へのやさしい解説

「高級ステーキばかり焼くようになったせいで、街からハンバーガーが消えてしまった」状態

この状況を、お肉(メモリ)とレストラン(工場)に例えて説明します。

1. 「高級ステーキ(AI用HBM)」の注文が殺到  
今、世界中のIT大手が「AIを賢くするための最高級肉(HBM)」を、いくら払ってでも欲しいと言っています。
2. 普通の肉を作る場所がなくなる  
肉を焼く鉄板(工場の製造ライン)の広さは決まっています。高級ステーキは焼くのに時間がかかり、場所もたくさん取ります。シェフたちは儲かるステーキばかり焼くようになったので、これまで私たちが安く食べていた「ハンバーグ用のひき肉(PC・スマホ用メモリ)」を作る余裕がなくなりました。
3. その結果、どうなる？
  - 街のハンバーガーショップ(PCメーカーなど)は、ひき肉が手に入らず困り果てています。
  - ひき肉の値段もステーキにつられてどんどん上がり、結果として「普通のノートパソコン」や「普通のスマホ」の値段がこれからどんどん上がっていく、あるいは性能が抑えられてしまうこととなります。

結論:

「AIブーム」というと遠い世界の話に聞こえるかもしれませんが、その裏で\*\*「世界中のメモリがAIに吸い取られている」\*\*のが今の状況です。私たちが買うデジカメ、スマホ、パソコンの値段に直撃する、非常に身近で深刻な「物価高」のニュースと言えます。

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-06/eu-to-push-for-trusted-chips-as-part-of-new-drone-strategy>

ブルームバーグ(2026年2月6日付)が報じた、欧州連合(EU)の新しいドローン戦略に関するニュースの要約です。ファイル生成は行わず、こちらで直接解説します。

## 【ニュース要約】EU、新ドローン戦略で「信頼できるチップ」の使用を義務付けへ

EU(欧州連合)は、民間および防衛目的のドローン生産を拡大するための新しい戦略案を来週提示する予定です。その中核として、ハッキングや改ざんを防ぐための\*\*「信頼できる半導体(Trusted Chips)」\*\*の使用を推進する方針を固めました。

### 1. 主な内容

- 「信頼できるチップ」の導入: ドローンがサイバー攻撃を受けたり、外部から操作を乗っ取られたりするのを防ぐため、セキュリティが担保された「安全なチップ」の採用を求めます。
- ドローンの壁(Drone Wall): 領空侵犯などの脅威に対抗するため、国境付近の監視を強化する「ドローンの壁」構想をさらに進めます。
- ウクライナとの連携: ウクライナとのドローン同盟を加速させ、2027年初頭までにドローン技術の防衛研究センターを設立することを目指します。
- 共同演習: 加盟国間で連携するため、毎年ドローン警備の演習を行い、秋までには緊急対応チームを創設する計画です。

### 2. 背景

ロシアによるウクライナ侵攻以降、ドローンは戦場の主役となりましたが、同時に領空侵犯などの安全保障上のリスクも増大しました。EUは、ドローンの「脳」にあたる半導体が敵対国製であったり、脆弱性があったりすることを深刻なリスクと捉えています。

## ノンテクニカルな方向けの解説

\*\*「『空飛ぶコンピュータ』であるドローンの脳みそを、安全なものに限定する」\*\*という話です。

1. 「脳みそ」を乗っ取らせない  
ドローンは非常に便利な道具ですが、実は「空を飛ぶ小さなコンピュータ」です。もしその中に入っているチップ(脳みそ)に、悪意のあるプログラムが仕込まれていたり、簡単にハッキングされたりすると、ドローンそのものが「空飛ぶ凶器」になってしまいます。
2. 「どこで作られたか」を重視する  
EUは、どこの誰が作ったかわからないチップを使うのをやめて、「この会社のチップならサイバー攻撃に強いし、裏口(バックドア)も仕込まれていない」と保証された、\*\*「信頼できるチップ」\*\*だけを使おうとしています。
3. なぜこれが重要なのか？  
これまでドローンは「安さ」が重視されてきましたが、これからは「安全」が最優先になります。これにより、ドローンを作るメーカーは「どこの部品を使うか」を厳しく選ぶ必要が出てきます。

結論:

「便利だけど怖いドローン」を、\*\*「安全で信頼できるヨーロッパ基準のドローン」\*\*に変えていくことで、市民の生活や国の守りを固めようという、EUの強い決意を示したニュースです。

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-06/nvidia-led-boom-set-to-turn-chips-into-trillion-dollar-industry>

ブルームバーグの2026年2月6日付の記事「Nvidia-Led Boom Set to Turn Chips Into Trillion-Dollar Industry(エヌビディア主導のブームにより、半導体は1兆ドル産業へ)」の要約と解説をまとめました。

Semiconductor\_Trillion\_Dollar\_Market\_Analysis

2月6日 16:44

このニュースは、半導体業界が「一時的なブーム」ではなく、エネルギーや物流と同じように、人類が文明を維持するために不可欠な「巨大なインフラ産業」になったことを象徴しています。

他にも詳しく知りたい点があれば、お気軽にお尋ねください。

## 半導体産業「1兆ドル(約150兆円)時代」の幕開け

2026年2月6日のブルームバーグの報道によると、エヌビディア(Nvidia)が牽引するAIブームが、半導体業界の成長スピードを劇的に加速させています。

### 1. ニュースの核心: 当初の予想を上回る「1兆ドル」への到達

- 歴史的なマイルストーン: 半導体業界の年間売上高が、ついに\*\*1兆ドル(約150兆円)\*\*という大台に到達しようとしています。
- 予想の修正: 以前は「1兆ドルに届くのは2030年頃」と言われていましたが、AI需要が爆発したことで、その時期が数年も前倒しされる見通しとなりました。
- 成長率: 2024年から2026年にかけて、業界全体で「20%以上の成長」を3年連続で記録する勢いであり、これは1990年代のパソコン・インターネット黎明期以来の異常な成長スピードです。

### 2. なぜこれほどまでに成長しているのか?

- AIインフラへの巨額投資: Google、Microsoft、Amazon、Metaなどの巨大企業が、自社のAIを強化するためにエヌビディアのチップ(GPU)を数兆円規模で買い続けていることが最大の要因です。
- メモリと周辺技術の底上げ: チップそのものだけでなく、データを高速で送り出すための「特殊なメモリ(HBM)」などの周辺部品もセットで需要が激増し、業界全体の単価を押し上げています。

### 3. ノンテクニカルな方向けの解説: 何が起きているのか?

このニュースは、半導体が「単なる部品」から\*\*「世界のインフラ(基盤)」\*\*へと格上げされたことを意味しています。

【例え話: 新しい「電気」の誕生】100年前、電気が普及したとき、発電機や電線を作る産業が爆発的に成長しました。今の「半導体」は、まさにその\*\*「現代版の電気」\*\*のような存在です。

- これまでの半導体: パソコンやスマホを動かすための「脇役」
- これからの半導体: AIという「新しい知能」を動かすための、国家レベルに必要な\*\*「戦略的資産(新しい石油や電気)」\*\*

結論: これまで「波がある(景気に左右されやすい)」と言われていた半導体業界が、AIという強力なエンジンを手に入れたことで、\*\*「世界で最も重要な巨大産業」\*\*へと完全に脱皮したというニュースです。